

# NVIDIA 入局 Corning 锁定光互联核心产能, 筑牢 AI 算力供应链根基

——电子行业周报 (2026/5/4-5/10)

## 行业及产业

电子

## 强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势:



资料来源: 聚源数据, 爱建证券研究所

## 相关研究

《电子行业周报: HBM 迭代筑牢 Samsung AI 芯片壁垒》2026-05-06

《电子行业周报: DeepSeek 发布并同步开源 V4 大模型》2026-04-27

《电子行业周报: AI 需求持续高景气, 先进制程产能加速扩张》2026-04-20

《电子行业周报: Samsung 2026Q1 业绩指引创历史新高》2026-04-13

《电子行业周报: AI 算力拉动半导体设备国产替代, 消费电子新兴赛道加速落地》2026-04-07

## 投资要点:

- 本周 (2026/5/4-5/10) SW 电子行业指数 (+6.03%), 涨跌幅排名 2/31 位, 沪深 300 指数 (+1.34%)。SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为: 通信 (+7.86%), 电子 (+6.03%), 机械设备 (+5.87%), 计算机 (+5.81%), 建筑材料 (+5.70%), 涨跌幅后五分别为: 石油石化 (-6.14%), 煤炭 (-5.06%), 银行 (-1.24%), 食品饮料 (-1.14%), 农林牧渔 (-0.97%)。本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是: 光学元件 (+12.09%), 印制电路板 (+8.94%), 集成电路封测 (+8.71%), 涨跌幅后三分别是: 品牌消费电子 (-0.03%), 半导体设备 (+0.73%), 模拟芯片设计 (+2.54%)。
- 本周 SW 电子行业涨跌幅排名前五的股票分别是: 唯特偶 (+33.77%), 波导股份 (+33.12%), 东田微 (+32.83%), 菲沃泰 (+28.32%), 昀冢科技 (+27.71%)。涨跌幅排名后五的股票分别是: 闻泰科技 (-14.30%), 华特气体 (-12.40%), 金宏气体 (-10.29%), 深华发 A (-9.65%), 广钢气体 (-8.05%)。
- **2026年5月6日, NVIDIA 与 Corning 正式宣布达成多项战略合作。**根据双方协议, Corning 计划将其在美国的光连接制造能力提升 10 倍、光纤产量提升超 50%, 同时将在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工厂; 本次合作中, NVIDIA 对 Corning 的总投资上限达 32 亿美元, 投资分为两部分落地, 首先投入 5 亿美元通过预融资认股权证获得 300 万股 Corning 普通股, 同时还获得一份传统认股权证, 有权在未来以每股 180 美元的价格追加购买最多 1500 万股 Corning 股票, 这笔追加投资的最高规模为 27 亿美元, 此次合作是 NVIDIA 针对光互联环节的产能布局动作, 将进一步巩固其在供应链中的话语权。
- **2026年5月6日, Lumentum 发布 2026 财年第三季度财报。**财报数据显示, 公司该季度营收达 8.08 亿美元, 同比+90.1%; 净利润为 2.26 亿美元; 据 GAAP 计算, 毛利率为 44.2%, 营业利润率为 21.6%, 摊薄每股收益 1.50 美元。业务结构方面, 组件业务收入 5.33 亿美元, 同比+77%, 占总营收 66%; 系统业务收入 2.75 亿美元, 同比+121%, 占总营收 34%。尽管本季度业绩表现亮眼, 公司仍面临严重的供需失衡。公司 CEO Hurlston 表示, 当前供应远无法满足需求, 供需缺口较上一季度的 25%-30% 进一步扩大, 已超 30%。其中, EML、泵浦激光器供应最为紧张, 泵浦激光器需求出现超预期的突发性激增, 公司对客户进行交付优先级划分; 光电路交换机 (OCS) 出货同样受供应链限制, 成为公司当前最大的交付压力项, 即便已与客户签订多长期数十亿美元的采购协议, 仍难以匹配过快增长的需求。为缓解供需矛盾, 公司计划未来四个季度内, 依托美国本土 Rose Orchard 工厂大幅提升泵浦激光器产量; 同时加大资本开支力度, 本季度资本开支达 1.25 亿美元, 重点用于扩充面向云厂商与 AI 客户的核心制造产能。业绩展望方面, 公司预计 2026 财年第四季度营收 9.6 亿-10.1 亿美元, 非 GAAP 口径营业利润率 35.0%-36.0%, 非 GAAP 摊薄每股收益 2.85-3.05 美元。
- **投资建议:** NVIDIA 32 亿美元战略绑定康宁扩产光连接产能、全球光器件龙头 Lumentum 2026 财年第三季度业绩向好, 凸显 AI 光互联全产业链在 AI 算力基础设施中的核心地位。全球 AI 算力扩张带动光互联需求持续爆发, 核心环节供需缺口持续扩大, 叠加相关环节技术壁垒高、扩产周期长, 行业景气度向全链条深度传导, 量价齐升红利持续释放, 建议重点关注 AI 光互联领域国产上市公司的投资机会。
- **风险提示:** 1) 行业竞争加剧风险; 2) 技术迭代不及预期风险; 3) 国际贸易摩擦与地缘政治风险。

## 证券分析师

许亮  
S0820525010002  
0755-83562506  
xuliang@ajzq.com

## 联系人

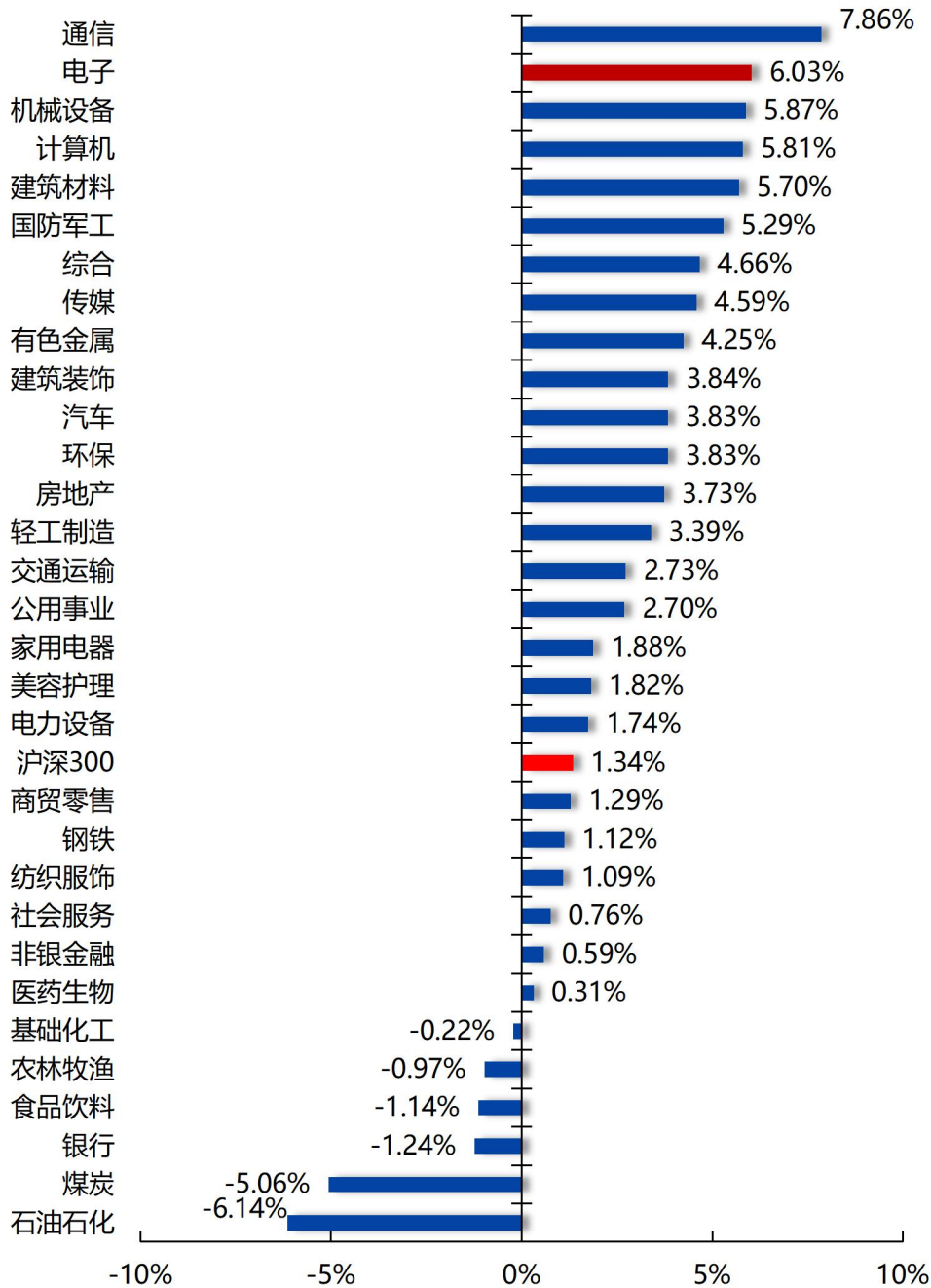
朱俊宇  
S0820125040021  
021-32229888-25520  
zhujunyu@ajzq.com

## 1. 本周市场回顾

### 1.1 SW 一级行业涨跌幅一览

本周 SW 电子行业指数 (+6.03%)，涨跌幅排名 2/31 位，沪深 300 指数 (+1.34%)。SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为：通信 (+7.86%)，电子 (+6.03%)，机械设备 (+5.87%)，计算机 (+5.81%)，建筑材料 (+5.70%)，涨跌幅后五分别为：石油石化 (-6.14%)，煤炭 (-5.06%)，银行 (-1.24%)，食品饮料 (-1.14%)，农林牧渔 (-0.97%)。

图表 1：本周 SW 一级行业涨跌幅一览

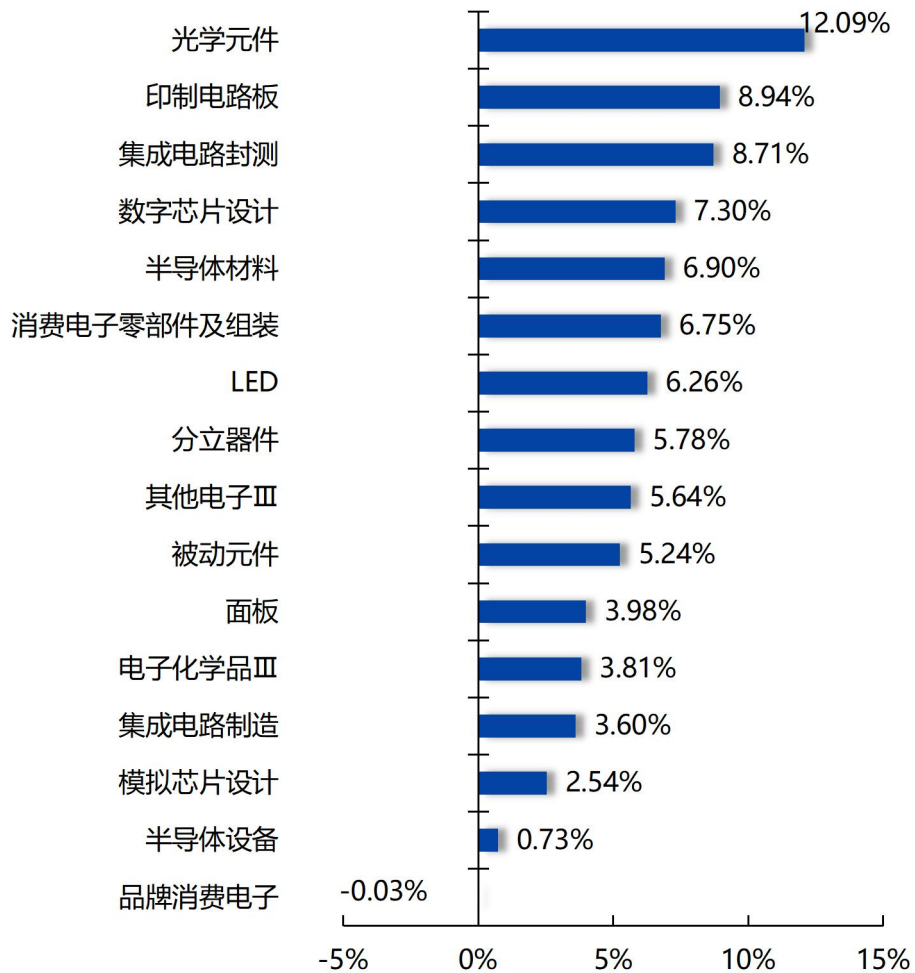


资料来源：iFinD，爱建证券研究所

## 1.2 SW 电子三级行业市场表现

本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：光学元件 (+12.09%)，印制电路板 (+8.94%)，集成电路封测 (+8.71%)，涨跌幅后三分别是：品牌消费电子 (-0.03%)，半导体设备 (+0.73%)，模拟芯片设计 (+2.54%)。

图表 2：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览



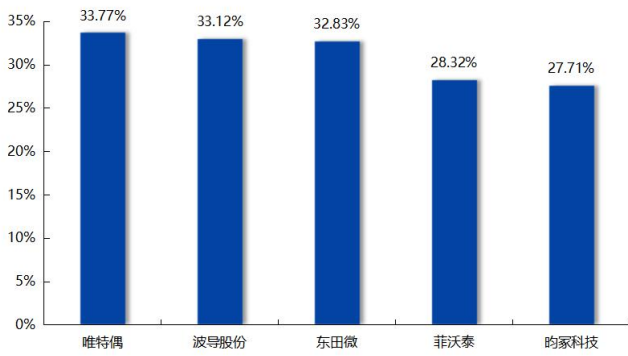
资料来源：iFinD，爱建证券研究所

## 1.3 SW 电子行业个股情况

本周 SW 电子行业涨跌幅排名前五的股票分别是：唯特偶 (+33.77%)，波导股份 (+33.12%)，东田微 (+32.83%)，菲沃泰 (+28.32%)，昀冢科技 (+27.71%)。

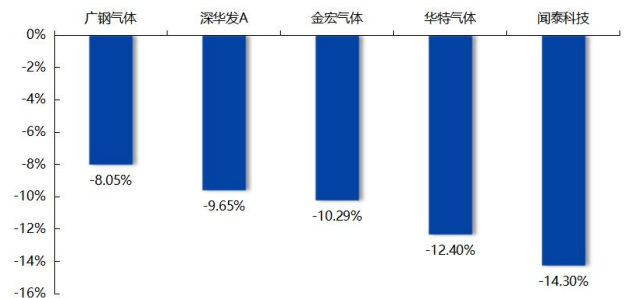
涨跌幅排名后五的股票分别是：闻泰科技 (-14.30%)，华特气体 (-12.40%)，金宏气体 (-10.29%)，深华发 A (-9.65%)，广钢气体 (-8.05%)。

图表 3: SW 电子个股本周涨跌幅前五



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

图表 4: SW 电子个股本周涨跌幅后五

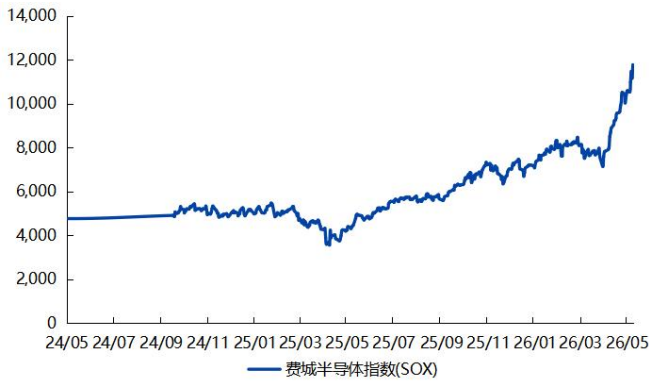


资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

### 1.4 SW 科技行业其他市场表现

半导体指数 (SOX) 本周涨跌幅为+11.14%，恒生科技指数本周涨跌幅为+4.75%。

图表 5: 本周费城半导体指数涨跌幅为+11.14%



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

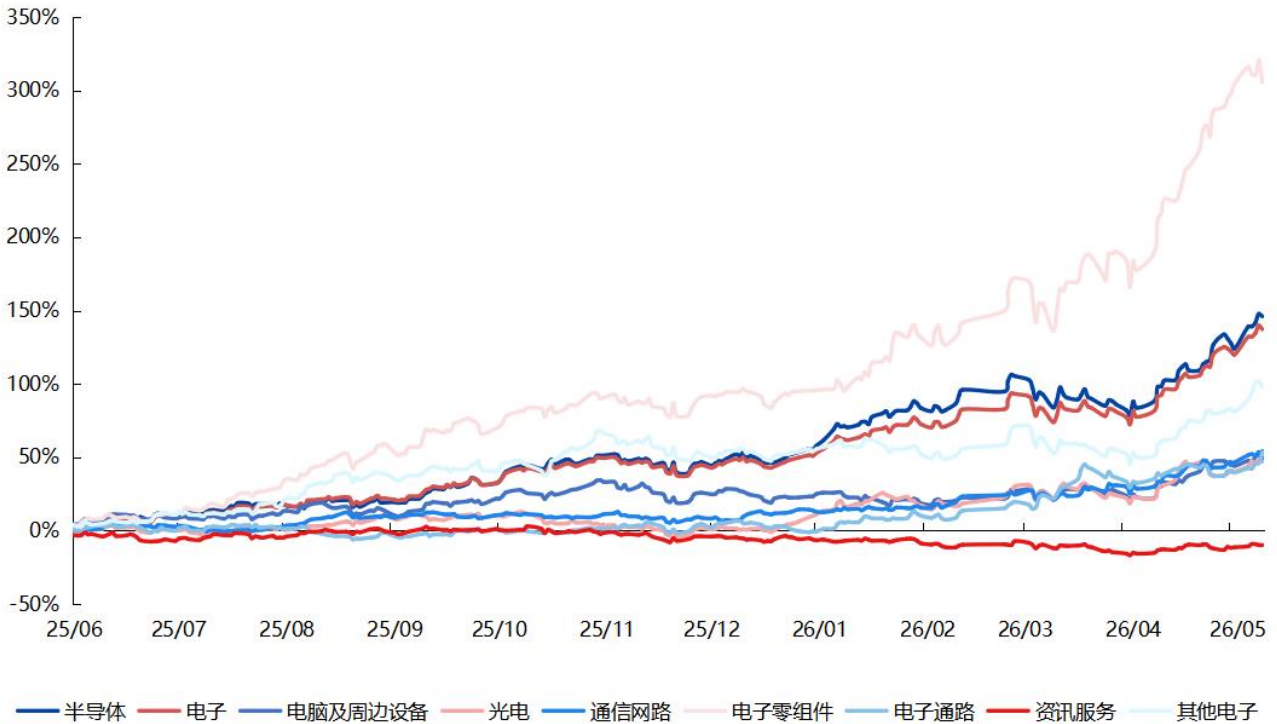
图表 6: 本周恒生科技指数涨跌幅为+4.75%



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

中国台湾电子指数各板块本周涨跌幅分别是：半导体 (+9.88%)，电子 (+7.92%)，电脑及周边设备 (+6.96%)，光电 (+4.70%)，通信网路 (+1.97%)，电子零组件 (+0.35%)，电子通路 (+9.92%)，资讯服务 (+1.74%)，其他电子 (+9.32%)。

图表 7：2025 年 6 月-2026 年 5 月中国台湾电子指数涨跌幅一览



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

## 2. 全球产业动态

### 2.1 NVIDIA 与 Corning 宣布达成战略合作

2026年5月6日，NVIDIA 与 Corning 宣布达成多起战略合作。

根据双方协议，Corning 计划将其在美国的光连接制造能力提升 10 倍，光纤产量提升超 50%，同时将在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工厂。

本次合作中，NVIDIA 对 Corning 的总投资上限达 32 亿美元，投资分为两部分落地：NVIDIA 首先投入 5 亿美元，通过预融资认股权证获得 300 万股 Corning 普通股；同时，NVIDIA 还获得一份传统认股权证，有权在未来以每股 180 美元的价格追加购买最多 1500 万股 Corning 股票。

此次合作不仅是 NVIDIA 锁定光互联环节关键产能的重要举措，更标志着其对供应链的话语权进一步强化。

### 2.2 Lumentum 发布 2026 财年第三季度财报

2026年5月6日，Lumentum 发布 2026 财年第三季度财报。财报数据显示，公司该季度营收达 8.08 亿美元，同比+90.1%；净利润为 2.26 亿美元；据 GAAP 计算，毛利率为 44.2%，营业利润率为 21.6%，摊薄每股收益 1.50 美元。

业务结构方面，组件业务收入 5.33 亿美元，同比+77%，占总营收 66%；系统业务

收入 2.75 亿美元，同比+121%，占总营收 34%。

尽管本季度业绩表现亮眼，公司仍面临严重的供需失衡。公司 CEO Hurlston 在业绩电话会上表示，当前供应远无法满足需求，供需缺口较上一季度的 25%-30%进一步扩大，已超 30%。其中，EML、泵浦激光器供应最为紧张，泵浦激光器需求出现超预期的突发性激增，公司已不得不对客户进行交付优先级划分；光电路交换机 (OCS) 出货同样受供应链限制，成为公司当前最大的交付压力项，即便已与客户签订多年期数十亿美元的采购协议，仍难以匹配过快增长的需求。为应对供需缺口，公司正加速推进产能扩张：计划未来四个季度内，依托美国本土 Rose Orchard 工厂大幅提升泵浦激光器产量；同时加大资本开支投入，本季度资本开支达 1.25 亿美元，主要用于扩充面向云厂商与 AI 客户的制造产能。

业绩展望方面，公司预计 2026 财年第四季度营收 9.6 亿-10.1 亿美元，非 GAAP 口径营业利润率 35.0%-36.0%，非 GAAP 摊薄每股收益 2.85-3.05 美元。

### 2.3 Applied Material 宣布收购 ASMPT 旗下 NEXX 大面积先进封装沉积设备业务

美国时间 2026 年 5 月 3 日，Applied Material 宣布已就收购后者的 NEXX 大面积先进封装沉积设备业务与 ASMPT 达成最终协议。ASMPT NEXX 主营半导体先进封装沉积设备，核心产品为 PVD 溅射、ECD 电化学沉积设备，覆盖晶圆级溅射、晶圆级电镀、面板级电镀全品类，可适配晶圆级封装、2.5D/3D 封装、扇出封装、嵌入式芯片等高端应用场景。

当前芯片架构正加速向 2.5D/3D 异构堆叠演进，大尺寸中介层与先进基板需求持续放量，推动封装工艺从传统 300mm 晶圆向 510×515mm 超大面板级切换；面板级封装可大幅提升芯片集成度、实现产能规模化扩张，已成为 AI 芯片先进封装的主流发展方向。

Applied Material 表示，本次收购将补齐公司面板级先进封装设备的业务短板，通过整合 NEXX 的技术团队与成熟产品线，重点支撑大尺寸、高性能、高能效 AI 加速器芯片的研发与量产。

### 2.4 力积电或将成功打入 Intel EMIB 先进封装供应链

据 CMoney2026 年 5 月 7 日报道，晶圆代工厂力积电或将成功打入 Intel EMIB 先进封装供应链。

力积电与 Intel 合作推进的 EMIB 相关项目已进入后段验证阶段，其中 12 寸整合型被动元件 (IPD) 平台已完成国际大厂认证；公司规划至 2027 年下半年起，单月投片需求预计 1 万片左右。

经营数据方面，力积电 2026 年 3 月合并营收达 47.32 亿元，创下近 41 个月以来新

高，年增率达 28.25%。

### 3. 风险提示

**1) 行业竞争加剧风险：**同行加速扩产导致行业供需格局逆转，引发产品价格与毛利率下滑。

**2) 技术迭代不及预期风险：**光互联行业技术迭代速度快，高速率光芯片、CPO 等新技术路线研发投入大、客户验证周期长，若企业技术研发、产品迭代进度不及行业发展节奏，将面临市场份额流失的风险。

**3) 国际贸易摩擦与地缘政治风险：**光互联产业链全球化分工特征显著，若国际贸易摩擦加剧、海外出口管制政策收紧，将对行业供应链稳定、企业海外市场拓展产生不利影响。

## 爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

## 评级说明

### 投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

### 股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~15%之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5%~5%之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%

### 行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

## 分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

## 法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

## 版权声明

本报告版权归爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。